BGA无卤素底部填充胶，芯片底部填充剂厂家

产品名称	BGA无卤素底部填充胶，芯片底部填充剂厂家
公司名称	东莞市天诺新材料科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	东莞市常平镇司马村三队12号B栋（注册地址）
联系电话	0769-81019906 18922548981

产品详情

东莞市天诺新材料科技有限公司为您提供BGA CSP无卤素底部填充胶、底部填充胶价格、优质底部填充胶厂家。可根据SMT工艺调整固化温度和时间，一切为客户所想！
1、天诺提供用于倒装芯片、CSP(FBGA)和PGA设备的创新型毛细流动底部填充剂。
2、是一种高流动性、高纯度的单组份灌封材料，它能形成均匀且无空洞的底部填充层，能有效降低由于芯片与基板的热膨胀系数不匹配或外力造成的冲击，提高产品的可靠性和机械性能。
3、底部填充剂可以对极细间距的部件进行快速填充，具有快速固化的能力，拥有较长的工作寿命。
4、可返修性。可返修性允许清除底部填充剂以便对线路板再度加以利用，从而节约了成本。
底部填充胶简单来说就是底部填充之义,常规定义是一种用化学胶水（主要成份是环氧树脂）对BGA封装模式的芯片进行封装模式的芯片进行底部填充，利用加热的固化形式，将BGA 底部空隙大面积(一般覆盖一般覆盖80%以上)填满，从而达到加固的目的，增强BGA 封装模式的芯片和PCBA 之间的抗跌落性能之间的抗跌落性能。底部填充胶还有一些非常规用法，是利用一些瞬干胶或常温固化形式胶水在BGA 封装模式芯片的四周或者部分角落部分填满，从而达到加固目的。 应用原理
底部填充胶的应用原理是利用毛细作用使得胶水迅速流过BGA
芯片底部芯片底部，其毛细流动的最小空间是10um。
这也符合了焊接工艺中焊盘和焊锡
球之间的最低电气特性要求，因为胶水是不会流过低于4um的间隙，所以保障了焊接工艺的电气安全特性。 流动现象 底部填充胶的流动现象是反波纹形式，黄色点为底部填充胶的起点位置，黄色箭
头为胶水流动方向，黄色线条即为底部填充胶胶水在BGA 芯片底部的流动现象，于是通常底部填充胶在生产流水线上检查其填充效果，只需要观察底部填充胶胶点的对面位置，即可判定对面位置是否能看到胶水痕迹。